

股票代码：300429

股票简称：强力新材

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与强力新材 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 05 月 07 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：钱晓春先生 总裁：张学龙先生 独立董事：谭文浩先生 职工代表董事、副总裁兼董事会秘书：倪寅森先生 副总裁兼财务总监：潘晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：强力转债 11 月到期，贵公司怎么解决可转债。 答：公司高度重视可转债到期事项。当前公司经营稳健，股价有一定的支撑，公司将尽力做好经营，积极推动可转债转股。同时，公司已制定资金到期兑付备选方案，将依法依规保障投资者权益。无论最终实现转股，还是到期兑付，公司均严格遵守募集约定，保障该事项平稳落地。谢谢！ 2、问：1、市值管理，贵公司 2026 年将如何管理，保障投资者利益； 2、贵公司产品的竞争力主要体现在哪些方面； 3、贵公司新产品的验证和投产进展情况如何；

答：1、公司始终坚持以基本面为核心，不炒作、不蹭热点、不短期造势，从根本上维护全体投资者的合法权益。公司将坚持深耕主业，扎实经营，提升核心竞争力；严格规范公司治理，健全内控体系，合规经营、规范信披，保障所有投资者信息公平；加强投资者关系管理，做好价值传递；严控经营与财务风险，保障公司长期稳健发展。 2、公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：技术和创新优势、稳定且优质的客户、产品配套及服务优势、人才优势。详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。 3、公司除积极开展现有主营业务外，还在积极研发推进新产品，例如应用于半导体先进封装领域的光敏性聚酰亚胺(PSPI)及电镀铜、镍、锡银等电镀液产品。公司的光敏性聚酰亚胺(PSPI)产品包括 350℃高温固化、250℃低温固化及 180℃超低温固化三种类型以及电镀铜、镍、锡银等电镀液产品。部分电镀液产品在客户处处于量产化导入验证阶段；近期公司高温 PSPI 产品，收到贸易商百公斤级订单，该订单的产品应用于前制程(应力缓冲层 Buffer coat)，订单金额不足两百万元人民币，该订单不会对公司经营产生重大影响，且公司无法保证该贸易商的后续订单是否具有持续性。敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

3、问：我想问问贵公司，PSPI 一期（产能 259 吨/年）预计 2026 年投产或量产，这个是真的今年落地？？有客户订单了吗？

答：公司年产 395.2 吨半导体先进封装材料项目，分两期建设：一期项目投资建设 259t/a 半导体先进封装材料项目，二期项目投资建设 136.2t/a 半导体先进封装

材料项目。目前一期项目已验收通过，具备量产化能力；二期处于建设过程中，具体事项按公司计划推进中。

4、问：强力新材股价在这一波先进封装涨价潮中会有什么表现吗？

答：感谢您对公司的关注。公司如涉及需履行决策程序和信息披露义务的事项，将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求执行。公司始终坚持以基本面为核心，坚持深耕主业，扎实经营，提升核心竞争力；严格规范公司治理，健全内控体系，合规经营、规范信披；加强投资者关系管理，做好价值传递；严控经营与财务风险，保障公司长期稳健发展。谢谢！

5、问：尊敬的董秘，有市场传言，公司 pspi 已经小批量供货头部大厂，请问是否属实

答：近期公司高温 PSPI 产品，收到贸易商百公斤级订单，该订单的产品应用于前制程（应力缓冲层 Buffer coat），订单金额不足两百万元人民币，该订单不会对公司经营产生重大影响，且公司无法保证该贸易商的后续订单是否具有持续性。敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

6、问：公司二期先进封装材料项目开始建设了吗

答：公司年产 395.2 吨半导体先进封装材料项目，分两期建设：一期项目投资建设 259t/a 半导体先进封装材料项目，二期项目投资建设 136.2t/a 半导体先进封装材料项目。目前一期项目已验收通过，具备量产化能力；二期处于建设过程中，具体事项按公司计划推进中。

7、问：公司 2025 年归母净利润亏损 1.07 亿元，2026 年一季度亏损进一步扩大至 2881 万元（同比扩大 412%）。请管理层具体拆解亏损扩大的主要原因——是毛利率持续下滑、费用端压力加大，还是资产减值等因素主

导？各项业务的盈利拐点预计何时出现？

答：2026 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 -2,881.30 元，同比下降 412.48%，主要原因系：1、毛利率同比下降 3.4%；2、2026 年一季度较去年同期增加股份支付费用 683.93 万元；3、存货跌价损失较去年同期增加 614.58 万元；4、政府补助少于去年同期。公司将坚持深耕主业，扎实经营，提升核心竞争力；严格规范公司治理，健全内控体系，合规经营、规范信披；加强投资者关系管理，做好价值传递；严控经营与财务风险，保障公司长期稳健发展。谢谢！

8、问：今年计提资产减值与信用减值合计超 1 亿元，是拖累利润的主因之一。这些减值主要来自哪些客户和资产，后续是否还有大额减值压力，风控体系有没有实质性收紧？

答：2025 年，公司对各项资产进行了减值测试。存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计提存货跌价损失 5,133.81 万元；对存在减值迹象的固定资产，采用市场法对确认其公允价值进行评估，计提固定资产减值准备 3,589.92 万元；对存在减值迹象的在建工程，采用市场法确认其公允价值进行评估，计提在建工程减值准备 1,673.75 万元。后续公司将严格按照企业会计准则的要求，对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，审慎、充分计提资产减值损失。

9、问：2026 年如何才能降本增效，避免不必要的投入实现利润转正！

答：公司计划通过以下措施降本增效：1、财务与成本管理：完善财务制度与作业管理，全面预算管理，降低资金成本，优化资本结构和资金分配；2、运营与流程

优化：管理精益化，流程标准化，优化供应链管理，优化库存管理；3、人力与组织效能：提升人员产出、组织扁平化；4、业务聚焦，费用管控：积极推进高利润核心业务，管控各项费用支出。

10、问：PCB 与半导体光刻胶相关产品保持增长，但 LCD 光刻胶引发剂收入下滑明显，显示面板业务承压。公司对 LCD 板块是收缩还是坚守，未来产品结构会如何调整？

答：公司是全球主要的 LCD 光刻胶专用化学品供应商，LCD 光刻胶光引发剂营收较上年降低 7.78%，毛利率增加 4.63%，主要原因是 LCD 光刻胶产业链向国内转移，部分专利过期的光引发剂产品在国内受到低价冲击。面对这一问题，公司秉持创新引领理念，以市场为导向聚焦国内显示光刻胶行业问题与前瞻性技术，一方面积极配合客户开发适用于 OLED 和 CMOS 的新一代 CF 光刻胶用光引发剂，以保持肟酯类光引发剂市场领先地位；另外一方面，通过积极拓展黑色矩阵（BM）及彩色（RGB）光刻胶树脂市场份额，推进 CF 光刻胶用纳米颜料分散液市场销售，研发新一代高透过、高折射新型光学树脂等重点工作，努力实现公司显示面板专用材料业务板块增长。

11、问：公司上年规划的在建工程有哪些项目已经完成了？今年还有什么在建工程落地？

答：截至 2025 年 12 月 31 日，公司在建工程余额主要为长沙新宇光引发剂扩建工程项目。该项目已于 2026 年 2 月转固。截至 2026 年 3 月 31 日，公司在建工程余额主要为格林长悦高性能 UV-LED 绿色涂料项目等。

12、问：研发费用同比大增近 24%，重点投向半导体光刻胶光酸、单体等高阶材料。这些项目目前处于实验室、

中试还是客户端验证阶段，预计哪一年能贡献可观收入？

答：在半导体光刻胶关键原材料方面，公司主要布局的产品方向有：半导体 i 线光酸、半导体 KrF 光酸、半导体 ArF 光酸、自由基聚合 PHS 树脂、阴离子聚合 PHS 树脂。公司光酸产品主要技术指标能够满足下游行业应用需求。公司围绕 PFAS Free 课题方向，自主开发全新 i 线光酸新结构，已进入客户评价体系。自由基聚合 PHS 树脂目前已进入客户端进行连续放大验证；阴离子聚合窄分布 PHS 树脂试制样品客户反馈良好，正在进一步送样测试。

13、问：上年到现在高性能 PCB 电路板需求越来越大，贵公司能预估今年自家的 PCB 光引发剂会比上年更畅销吗？

答：公司是全球 PCB 干膜光刻胶光引发剂的主要供应商，产品已应用于 PCB 干膜光刻胶行业头部企业的高性能产品。近年，我们围绕先进封装应用新方向，创新开发多款自主结构新型干膜引发剂，其中两款产品在新一代半导体载板光刻胶测试评价中已表现出良好应用性能。

14、问：公司和盛合晶微的合作到哪一步了，产品是否已经通过验证？

答：您好，截至目前，公司的 PSPI 产品在盛合晶微仍处于验证中。谢谢！

15、问：经营现金流同比大幅改善，但投资现金流支出仍高，资本开支压力不小。未来两年扩产计划是否会放缓，资金来源主要靠自有现金流还是再融资？

答：目前公司主要建设项目已陆续完成建设，公司未来会根据经营战略及市场前景谨慎决策投资项目。未来公司会根据具体项目储备状况、资金需求及资本市场环

境，再行决定未来投资项目的资金来源。

16、问：尊敬的钱董，请问公司 PSPI 产品针对先进封装 RDL 制程，各头部客户分别处于实验室验证、线体适配、长期可靠性考核、小批量认证哪个阶段？行业常规全流程认证周期 12-24 个月，公司当前项目预计何时完成终端全流程验证并具备批量供货条件？

答：截至目前，公司 PSPI 产品已通过部分客户的结构片验证或真片验证。近期公司高温 PSPI 产品，收到贸易商百公斤级订单，该订单的产品应用于前制程（应力缓冲层 Buffer coat），订单金额不足两百万元人民币，该订单不会对公司经营产生重大影响，且公司无法保证该贸易商的后续订单是否具有持续性。敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

17、问：公司在 PCB 光刻胶引发剂全球市占较高，但行业竞争加剧、价格持续走低，导致产能利用率不足、固定成本偏高。打算通过提价、降本还是产品升级来改善毛利？

答：近年，国内部分 PCB 光刻胶引发剂产品竞争加剧、价格走低。面对这一问题，公司秉持创新引领理念，以市场为导向聚焦干膜光刻胶行业问题与前瞻性技术，一方面围绕先进封装应用新方向，创新开发新型干膜引发剂，另外一方面，积极开展阳离子干膜专用化学品、高 Tg 低介电树脂等创新研究。公司期望通过产品升级、业务拓展改善目前引发剂行业竞争加剧局面。

18、问：请问贵司 PSPI 产品有没有通过盛合晶微验证。

答：您好，截至目前，公司的 PSPI 产品在盛合晶微仍处于验证中。谢谢！

19、问：领导好，半导体国产化是行业大趋势，公司也在推进相关材料认证。目前进入头部半导体光刻胶厂商

供应链的具体进展如何，已批量供货还是仅送样测试？

答：在半导体光刻胶关键原材料方面，公司主要布局的产品方向有：半导体 i 线光酸、半导体 KrF 光酸、半导体 ArF 光酸、自由基聚合 PHS 树脂、阴离子聚合 PHS 树脂。公司光酸产品主要技术指标能够满足下游行业应用需求。公司围绕 PFAS Free 课题方向，自主开发全新 i 线光酸新结构，已进入客户评价体系。自由基聚合 PHS 树脂目前已进入客户端进行连续放大验证；阴离子聚合窄分布 PHS 树脂试制样品客户反馈良好，正在进一步送样测试。

20、问：有市场传闻，贵司已经通过盛合晶微验证，并成功进入华为昇腾供应链，是否属实

答：您好，该情况不属实。谢谢！

21、问：应收账款增速高于营收，部分客户账期拉长，叠加减值计提增加。公司对客户信用等级有没有重新划分，2026 年回款率和周转天数目标是多少？

答：2025 年公司计提的信用减值损失增加主要系年末应收账款余额增加。公司会根据客户的信用状况适当划分客户的信用等级。2026 年公司将积极与客户沟通，促进应收账款回笼，保证公司运营资金良好周转。

22、问：作为国内 PSPPI 产品的龙头企业，国产替代需求怎样？目前公司的产品已稳定供货盛合晶微，盛和晶微产品用于 昇腾/鲲鹏芯片 先进封装，盛和晶微上市后扩产对公司有何积极影响？展望 26 年整体业绩，公司有何具体计划实现扭亏吗？

答：截至目前，公司 PSPPI 产品在盛合晶微仍处于验证中。公司今后将坚持深耕主业，通过强化销售，继续保证研发投入，全方位降本增效，完善及落实人才发展建设等措施，努力做好公司经营。

	<p>23、问：那么公司的 pspi 通过了哪些公司的认证呢？ 或者说跟哪些公司认证取得了进展</p> <p>答：您好，具体客户名称不方便透露。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2026 年 05 月 07 日